

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

本期业绩预告适用类型：净利润为负值。

经西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司 2025 年年度业绩预告如下：

1、预计 2025 年年度实现营业收入约 265,000.00 万元，与上年同期相比将增加约 52,854.74 万元，同比增加约 24.91%。

2、预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润约-73,800.00 万元，与上年同期相比基本持平。

3、预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约-80,900.00 万元，与上年同期相比，亏损将扩大约 4,644.91 万元，同比扩大约 6.09%。

4、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）利润总额：-73,764.25 万元。归属于母公司所有者的净利润：
-73,764.25 万元。归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润：
-76,255.09 万元。

（二）每股收益：-0.21 元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，全球半导体行业迎来结构性复苏周期，人工智能、数据中心等应用对算力及存储领域需求的增长成为驱动行业增长的核心引擎，行业整体处于筑底调整与动能积蓄阶段，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。受益于半导体行业的逐步复苏，半导体硅片市场呈现向好态势，根据国际半导体产业协会（SEMI）数据显示，2025 年全球半导体硅片出货面积预计同比增长 5.4%。公司紧抓行业复苏窗口期，积极推进市场拓展与产能建设双重布局，经营规模实现持续提升，2025 年产品销量及营业收入较 2024 年同期均保持增长，其中营业收入同比提升约 24.91%。

从市场环境来看，尽管半导体行业复苏态势明确，但下游客户需求向半导体硅片环节的传导存在滞后性。同时，公司第二工厂正处于产能爬坡阶段，产品结构处于持续优化中。成本与研发层面，由于产能尚未完全释放，规模效应暂未充分显现，固定资产折旧等固定成本未能实现有效摊薄；加之公司为保障核心竞争力，持续维持较高强度的研发投入，多重因素共同导致报告期内公司仍存在业绩亏损。值得关注的是，公司经营性现金净流入保持为正，具备良好的可持续经营能力。

随着半导体硅片市场进一步复苏，叠加公司产品结构优化及规模效应的进一步显现，将推动公司盈利能力持续改善，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

四、风险提示

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据，截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日